

米中ハイテク摩擦と半導体産業の技術デカップリング

本報告では、米中貿易摩擦の最大の品目でもある半導体を取り上げ、半導体産業の技術デカップリングについて論じたい。中国サイドからみると半導体、特にIC（集積回路）は技術的に劣位ある産業であることから石油を超える貿易赤字の最大の品目であり、アメリカサイドからみると技術的に優位にあり、安全保障にもかかわる半導体関連の技術流出が懸念されている産業である。そのため、米中ハイテク摩擦の焦点の1つに半導体関連産業が位置づけられるのである。

中国の半導体産業は、設計分野においては急速に能力を向上させた。しかし、設計したチップを生産する能力、つまり半導体の製造工程、特に前工程と半導体製造装置の国産化が遅れており、外国の先端技術に多くを依存している。アメリカも対中においてはその主要な顧客であることから一部では妥協をせざるを得ないと考えられる。ローエンドの製造装置については制限をかけるものの、ハイエンドの製造装置については落としどころを探っていくと考えている。